



## COMPANY PROFILE



# WIN-WINの仕事で世界NO.1の商品を創ろう

東京精密のコーポレートブランド **ACCRETECH** は、Grow Together という意味の ACCRETE と TECHNOLOGY の合成語で、

「世界中の優れた技術・知恵、情報を融合して世界 No.1 の商品を作り出し、皆様と共に大きく成長していく」

という当社の企業理念を一語で表したものです。



## ごあいさつ

私たち東京精密グループは、1949年の創業以来、「お客さまの満足」を追求し、製品開発とカスタマー・サポートに注力してまいりました。皆さまのご支援のおかげで、現在では世界18の国と地域にグループ会社を有するグローバル企業へと成長いたしました。

東京精密グループのバーパス（存在意義）は「計測で未来を測り、半導体で未来を創る」です。このバーパスに基づき、東京精密グループは“夢のある未来”を築くため、世界中の優れた技術・知恵・情報を融合して世界No.1の商品を創り出し、皆さまと共に大きく成長していくことを目指しています。

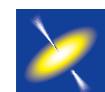
社会は急速に変化しており、グローバル化、環境問題への対応、デジタル化の進展が進んでいます。東京精密グループは、これらの変化に対応し、創業以来培ってきた技術を突き詰め、技術革新を成し遂げる力と計測技術を持つ半導体製造装置メーカーとしての強みを活かし、お客様のモノづくりのイノベーションを支援し続けます。

東京精密グループは、「健康・安全」「品質」「環境・省エネルギー」「全員力」という行動指針を基に、優れた半導体製造装置と精密測定機器を開発・供給し、お客様にご満足いただくと共に、社会に貢献してまいります。

今後とも皆さまの温かいご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



代表取締役社長CEO  
木村 龍一



※シンボルマークの表現している内容

高速回転する金色の物体は、世界中から集めたリソース（人、物、金、情報）を表しており、この力を凝縮し、明確なターゲットを持って、最先端の強力な製品を市場に投入していく様を、物体中央から噴出している高速ジェット流で表しています。

# 東京精密は、これまで培って きたコアテクノロジーに基づき、 世界 No.1 商品を継続的に市 場に投入していきます。

東京精密は、精密測定機器と半導体製造装置メーカーとして精密位置決め技術、精密測定技術をバックボーンにマシンコントロールゲージ、表面粗さ測定機、ウェーハプロービングマシンなどの装置を市場に提供してきました。今後、東京精密は、これまで培ってきたこれらのコア・テクノロジーに基づき、世界 No.1 の新商品を続々と市場に投入していきます。

確かな技術でニーズに  
お応えします。

計測を基盤に、さらなる成長を。

## 精密測定機器

High Precision Measuring Instruments

計測社は、世界の自動車業界・工作機械・航空機等あらゆる産業界に「高精度精密測定機器」を提供し、世界中のお客様に高い評価をいただいております。今後も、耐環境性の向上、小型化、オペレーションの自動化など、たゆまぬ開発をおこなってまいります。さらに、カーボンニュートラル社会の実現に向け、NEVや再生エネルギー市場などの新しいニーズにも対応するため、二次電池の性能評価システムの開発にも注力し、未来社会の創造に貢献してまいります。



最先端のものづくりを支えます。

半導体の技術進化と共に  
成長を続けます。

## 半導体製造装置

Semiconductor Production Equipments

半導体社は、従来のウェーハ製造分野及び、テスト分野、後工程分野で、世界のトップシェアを確立してまいりました。これらに加えCMP装置や薄片化分野にも進出し、半導体製造工程における、お客様の最適生産システム構築をサポートしております。

## 汎用計測機器 三次元座標測定機

## Coordinate Measuring Machines

高スループットを実現する、アクティブスキャニング技術・  
簡単操作を可能にするAI機能で、部品の高精度化に対応します。

東京精密は、日本で初めて三次元座標測定機を開発したパイオニアです。高スループットを実現するアクティブスキャニング技術や、高速スキャニング精度を飛躍的に向上するNavigator機能に加え、バーチャルセンター駆動などの革新的なテクノロジを搭載したXENOS。非破壊で微小な内部欠陥を可視化できるX線CT装置 METROTOMシリーズ。高精度・高速・耐温度環境性能を兼ね備えたAXCELシリーズなど、使用目的にマッチした様々な三次元座標測定機を提供いたします。



ZEISS XENOS®

- 超高精度 CNC三次元座標測定機
- 最大許容長さ測定誤差 ( $E_0$ ) ( $\mu\text{m}$ ):  $0.3+L/1000$
- センタードライバから更に進化したY軸ドライブ構造
- 本体の主要構造部品に革新的な炭化ケイ素セラミックを採用

ZEISS PRISMO® シリーズ **NEW**

- スタンダードタイプに加え、  
超高精度タイプ ultra、  
高精度タイプ verity、  
現座対応タイプ fortis をラインナップ
- 高速スキャニング精度を飛躍的に向上する  
Navigator機能を搭載
- アクティブスキャニングプローブ VAST  
goldを採用し、スキャニング測定、ポイント  
測定のいずれも、高速・高精度な測定を実現



ZEISS CONTURA®

- 構造やデザインを一新し、生まれ変わった  
CONTURAシリーズ
- マルチセンサシステムにより、高精度アクティブ  
スキャニング測定や首振りスキャニング測定、  
非接触測定に1台で対応可能に
- アクティブスキャニングプローブ標準搭載の  
aktiv、回転式プローブヘッド標準搭載の  
RDSをラインナップ

ZEISS MICURA **NEW**

- 接触式測定に特化した高精度モデル
- ZEISS VASTテクノロジと  
ロータリーテーブルで効率良く測定
- 2つのエコ機能でランニングコスト削減



XYZAX AXCEL RDS

ザイザックス AXCEL RDS / PH シリーズ

- 最大許容長さ測定誤差 ( $E_0$ , MPE) ( $\mu\text{m}$ ):  $1.8+3L/1000$
- 駆動機構の見直しにより実現した、驚異のスピード  
駆動速度 最大 700 mm/sec、  
加速度 最大 2300 mm/sec<sup>2</sup>
- 格段に向上した耐環境性能  
精度保証温度 15°C ~ 30°C
- 2軸回転式ヘッド RDSと  
スキャニングプローブ VAST XXT を搭載した  
スキャニング測定モデル (RDS)
- オプションのラインレーザプローブ、画像プローブ搭載で  
非接触測定にも対応 (RDS)
- 設置環境や予算に応じて様々な仕様を選択できる  
ポイント測定モデル (PH)



XYZAX AXCEL PH



ザイザックス mju NEX シリーズ

- 高剛性リニアガイド X、Y(右)、Z軸とエアペアリング Y(左) 軸  
を併用したハイブリッド構造で、エア消費量を1/4に  
・消費電力を大幅に低減して、ランニングコストを抑制
- Y軸測定範囲 760 mm の 5/8/4 サイズを新たにラインナップ
- リアルタイムスケール温度補正機能と振動に強く・長い  
スライラスが利用できるTP200Bを搭載
- 最大許容長さ測定誤差  
 $E_0$ , MPE:  $2.2+L/250 \mu\text{m}$  (18°C ~ 22°C)



ザイザックス SVF NEX シリーズ

- RVFシリーズのデザインを一新
- 新しく生まれ変わったエンタリーモデルのマニュ  
アル三次元座標測定機
- 長時間測定でも疲れない軽量設計
- 測定・ターミネート・中間点の操作スイッチを手  
元で操作でき、Z軸から手を離さずに測定可能



ZEISS O-DETECT

- 広視野かつ高精度、そのうえ簡単に操作できる  
革新的な三次元画像測定機
- ISO10360-7に準拠し、かつ3次元の長さ  
測定誤差を保証
- プログラム作成も測定も簡単に実行できる、  
オーバービュー・イメージ機能



ZEISS O-INSPECT

- さまざまなワークと評価範囲をカバー
- 接触式センサ VAST XXT を標準装備
- 画像センサ テレセンタリックズームレンズ Discoveryを標準装備
- 高さ方向の非接触形状測定が可能

## 汎用計測機器 表面粗さ・輪郭形状測定機

# Surface Texture and Contour Measuring Instruments



表面粗さ・輪郭形状統合測定機  
サーフコム CREST

- リニアモータ駆動部を搭載、高精度、高速測定を実現
- 世界最高クラスの高精度、高性能粗さ・輪郭統合測定機
- 高安定倍光路型レーザ干渉センサを採用
- 高分解能(分解能0.31 nm、測定レンジ13 mm)を実現
- 1回の測定で粗さと輪郭の評価解析が高効率で可能

## 表面粗さ・輪郭形状測定機

サーフコム CRESTは、高速・高精度・低振動という相反する要求を当社の独自技術で実現した高精度表面粗さ・輪郭形状統合測定機です。また、好評のリニアモータ駆動部により高速・低振動を実現し、高分解能検出器により高精度を実現した、世界最高クラスの性能を持った測定機です。1回の測定で表面粗さと輪郭形状の両方の評価解析が可能となるため、検出器の付け替え時間が節約されるとともに、測定部の高速化(200 mm/s)による高スループットを実現しました。また、リニアモータを搭載したサーフコム NEXシリーズ等もこれまでの概念を超えた低振動で高倍率測定が可能です。



### NEW 表面粗さ・輪郭形状測定機 サーフコム NEX シリーズ

- 新開発! ワイドレンジハイブリッド検出器
- タクトタイムを短縮する圧倒的な高速駆動
- 振動を最小限に抑え、高精度な測定を実現するリニアモータ駆動部



表面粗さ測定機  
サーフコム TOUCH 550

- オペレータの視点から操作性を追求した現場向け表面粗さ測定機
- 優れたGUIでインストラクションフリー
- 世界中で使えるマルチ言語対応(20か国語)
- レベリング、ゼロ点出しが容易な高分解能・ワイドレンジピックアップ

### 表面粗さ測定機 サーフコム TOUCH 35/40/45/50

- 持ち運びに便利なコンパクトサイズの表面粗さ測定機
- 優れたGUIでインストラクションフリー
- 世界中で使えるマルチ言語対応(20か国語)
- レベリング、ゼロ点出しが容易な高分解能・ワイドレンジピックアップ(TOUCH 50)
- ワークや測定箇所に応じて選択できる、手のひらサイズのハンディ駆動部(TOUCH 35/40/45)



### 表面粗さ測定機 ハンディサーフ<sup>+</sup> 35/40/45

- 洗練されたデザインで生まれ変わったポータブル表面粗さ測定機
- 世界中で使えるマルチ言語対応(20か国語)
- 優れた操作性と充実の解析機能
- クラストップレベルのZ方向測定レンジ 370 µmを有し、その全域で0.0007 µmの高分解能を実現

## 汎用計測機器 光学測定機器

# Optical Measuring Instruments



Opt-scope R

Opt-scope R 200

Opt-scope Rex

### 非接触三次元表面粗さ・形状測定機 Opt-scope

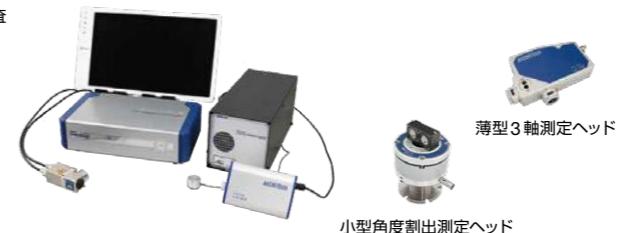
- 高分解能 0.01 nm
- 電動XYステージ移動範囲 Opt-scope R: 25/50 mm、Opt-scope R 200: 200 mm、Opt-scope Rex st 400: 400 mm
- 高速カメラオプションでスキャン速度が6倍にアップ

### 非接触干渉変位センサ Opt-measure

- 白色干渉法を用いた非接触変位センサ
- 高精度、広温度範囲、センサーへッドがコンパクトで光ファイバ光学系を採用し、センサーへッドと制御部を10 m以上離して使用することが可能
- 1つの制御部で、最大16本までセンサーを接続
- 測定精度: ±3.6 µm (15°C ~ 30°C)

### 光ファイバ結合レーザ干渉測長器ディスタックス

- 光ファイバー結合でセッティングが容易
- 工作機械の直線軸、回転軸を全自動検査



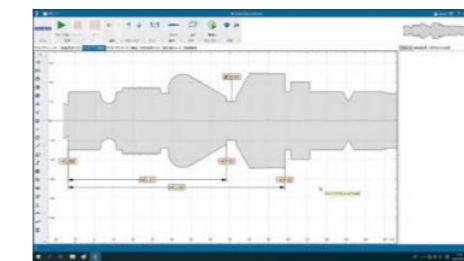
小型角度割出測定ヘッド



### NEW Shaftcom (シャフコム) Cシリーズ

#### 「高速」「高精度」測定を実現 生産現場にも設置できる光学式シャフト形状測定機

- 圧倒的な測定速度と高精度・高分解能測定を両立
- 生産現場にも設置できる優れた耐環境設計
- キー溝や穴などの形状も測定できる接触式プローブ(オプション)



**汎用計測機器 真円度・円筒形状測定機**

# Cylindrical Form Measuring Instruments

測定室からラインサイドへの展開を可能にします。



ロンコム CREST

- 回転精度は半径方向・軸方向ともに  $0.01 \mu\text{m}$
- 世界最高クラスの超高精度
- 新開発の非接触駆動・ガイド部により、極めて精密な位置決めと長期にわたる安定した精度保証を実現
- 真円度測定/表面粗さ測定の自動切替が可能な新開発測定カントロール検出器を搭載
- 繰り返し精度  $0.3 \mu\text{m}$  の超高精度直径測定

ロンコム 60A

- Z軸・R軸にエアペーリングを採用
- 回転精度  $0.02 \mu\text{m}$  を保証
- オートセンタリング・チルチング時間60秒以内を実現



NEW

真円度・円筒形状測定機  
ロンコム NEX シリーズ

- 1台3役の真円度・直径・表面粗さ測定機能とセレクタブルな仕様で、さまざまな測定ニーズに対応
- 省力化オプション AFD 測定カントロール検出器
- 省力化オプション XY 軸自動ステージ多数箇所・多数個の測定を劇的に効率化



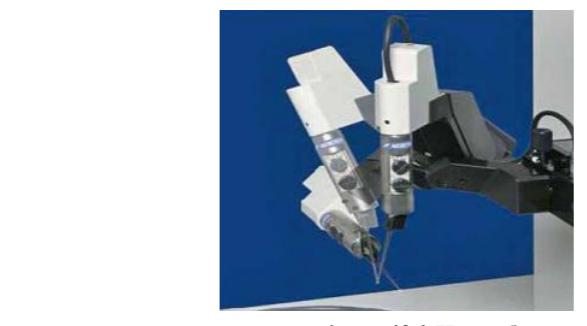
ロンコム 43C

- 自動測定機能により生産現場における量産・繰り返し測定に最適なマシン
- 真直度保証付きコラムを装備、円筒解析が行えるエコノミータイプ



ロンコム TOUCH

- 入門機に最適なエントリーラインの手動真円度測定機
- コラム移動型の独創的デザイン
- 設置面積を従来比50%以下に削減
- Windowsタブレットを採用タッチスクリーンにより誰でも使える高操作性を実現



オフセット型 CNC 検出器ホルダ

データ処理システム  
「ACCTee 真円度」

## ACCTee



- All in One Document !
- ACCTee は、新コンセプトの測定スタイルを提唱すべく開発。
- ドキュメントベースで測定や解析が行え、抜群の操作性を実現。
- Easy モードと Expert モードで初心者から高度な CNC プログラミングまで柔軟に対応



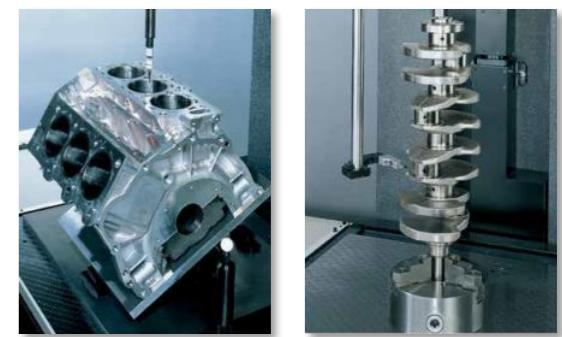
ロンコム 76A

- 高速駆動により測定のハイスクープ化を実現
- 測定箇所の位置決めから測定データの作成まで完全無人化を実現
- 実績のあるエアペーリングを搭載
- 世界最高水準の精度を実現
- 最大積載質量1トンまで対応可能(オプション)



ロンコム 73A

- クラス最高精度を実現
- シリンダブロックやクランクシャフト等の測定に最適
- 安全機構や CNC 機能が標準搭載



シリンダブロックやクランクシャフトの測定例

**汎用計測機器 ショップフロア(生産現場)対応測定機**

## Measuring Instruments for Shop Floor

東京精密がショップフロア(生産現場)の  
ライン計測に最新テクノロジを提案します。

測定効率の向上、コスト削減、および品質向上を目指し、ショップフロア(生産現場)での測定要求が高まっています。  
この要望に応え東京精密では、測定の自動化に対応し、耐環境性に優れたショップフロア向けの測定機を提供します。



ZEISS DuraMax®

ZEISS DuraMax®  
with Rotary Table

ZEISS DuraMax® HTG

**ZEISS DuraMax® / ZEISS DuraMax® HTG**

- 電源1本で測定準備OK、プラグ&プレイを実現
- スリムで省設置スペースのデスクトップタイプ
- 省エネ志向の三次元座標測定機
- 幅広い温度環境下で精度保証

最大許容長さ測定誤差  $E_0$ , MPE :  
ZEISS DuraMax®  
2.4 + L / 300  $\mu\text{m}$  (18°C ~ 22°C)  
2.7 + L / 250  $\mu\text{m}$  (18°C ~ 26°C)  
2.9 + L / 290  $\mu\text{m}$  (18°C ~ 30°C)  
3.9 + L / 100  $\mu\text{m}$  (15°C ~ 40°C)

最大許容長さ測定誤差  $E_0$ , MPE :  
ZEISS DuraMax® HTG  
2.2 + L / 300  $\mu\text{m}$  (18°C ~ 22°C)  
2.5 + L / 250  $\mu\text{m}$  (18°C ~ 26°C)  
2.7 + L / 200  $\mu\text{m}$  (18°C ~ 30°C)  
3.9 + L / 100  $\mu\text{m}$  (15°C ~ 40°C)

**汎用計測機器 超大型測定機**

## Measuring Instruments for Large Works

航空機、エネルギー、自動車、工作機械、印刷機などの  
大型で高精度な部品の測定に最適です。



超大型三次元座標測定機  
ZEISS MMZ-G シリーズ (フロア設置型)

- フロアそのものを測定テーブルとし、大型重量物の測定、ワークの搬送等が容易
- 大型の三次元座標測定機では、最高の測定精度を提供



大型三次元座標測定機  
ZEISS MMZ-T シリーズ  
(測定テーブル型)

- 大型ギア等の測定に理想的な精度と測定範囲

**充放電試験システム**

## Battery Test System

充放電試験システムとは、二次電池やキャパシタの研究・開発や品質保証(抜取り・信頼性検査)における充放電サイクル試験において、欠かせない計測システムです。近年益々加速する民生用モバイル機器から電気自動車まで幅広く活用される二次電池やキャパシタなどの性能試験から耐久試験を自動で試験することが出来るシステムです。

東京精密は、「充放電試験システム」・「電池治具」・「電池評価受託サービス」・「保守サービス」を提供しております。

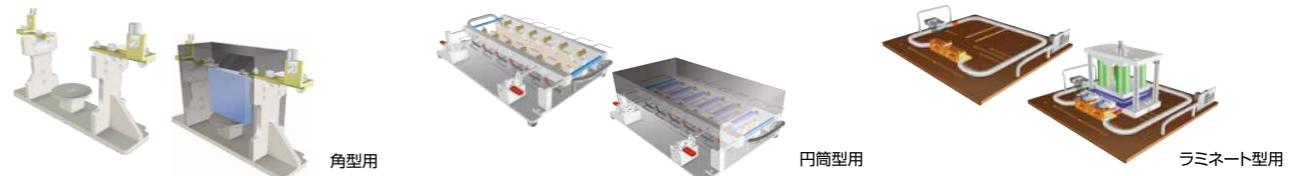
**充放電試験システム**

セル・モジュール・パック用二次電池やキャパシタの研究・開発／品質管理に応じて最適な性能試験を行うシステムです。



**電池治具**

二次電池・キャパシタなどを開発する際に行われるサイクル試験や特性試験における「安定した計測」「設備の安全」「人への安全」「省力化」を実現する電池評価治具を提供します。対象は、角型・円筒型・ラミネート型などあらゆる形状に応じて設計製作します。



**電池評価受託サービス**

長年をかけて培った電源装置技術と充放電試験システムのパイオニアとして、お客様の多種多様なニーズに対応した電池評価受託サービスをご提供いたします。

**「4つの強み」**

- 充放電試験システム開発・販売メーカーとしての技術力、お客様ニーズ対応力
- 100社、2,000台以上の顧客納入実績(試験ノウハウ)
- 豊富な専門スタッフと試験専門チーム + 電池評価・品質専門チーム
- 電池計測器・分析・認証機関メーカーとの強力なリレーション

**「新たな展開」**

- 輸送時の安全点検を実現する自社の電池専用便のサービス提供
- SDS (Safety Data Sheet) の情報による電池廃却処分のサービス提供
- 遠方のお客様でもリアルタイムに評価中のデータが確認できるリモート機能の提供



**保守サービス**

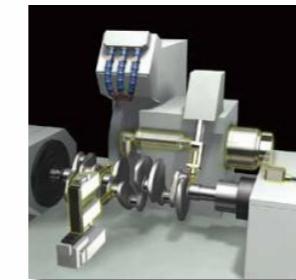
充放電試験システムの現地調整・移設・バージョンアップ・修理など充実したサービスを提供します。

## 自動計測機器

## In-Line Measuring Systems

100% のアップタイム、100% の良品作りを目指すユーザーの信頼に東京精密は応えてまいりました。

SBS オートバランサシステム



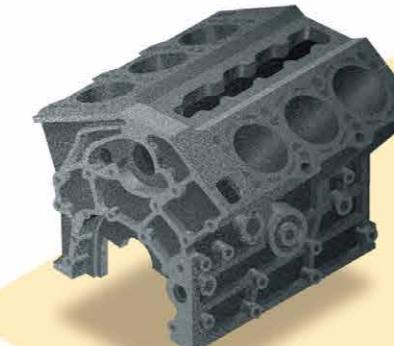
研削盤用測定システム

クランクシャフト加工ライン



外径測定

基準面切削加工



シリンダーブロック加工ライン

東京精密は、1960 年代の日本の自動車産業の勃興と共に、インラインの計測機器メーカーとしての歩みを始めました。それ以降、製造ラインに求められたものは何か？ それは、1 日 24 時間、週 7 日、1 年 365 日のフル稼働、100% の良品そして 100% のアップタイムです。東京精密は、インプロセスゲージによるリアルタイム制御、ポストプロセスゲージによるフィードバック制御、そしてそれらを統合したシステムにより、計測機器メーカーとしてお客様のニーズにお応えしてきました。そして、短納期、アプリケーションへの対応能力、高い信頼性など、トータルのサポート能力で高い評価を充ち取りました。またサイト毎の強力なサービス体制も東京精密の大きな特長です。インライン計測システム作りでの経験・実績こそ、現在の半導体製造装置をも含むインラインの総合精密測定機器メーカーとしての東京精密のバックグラウンドなのです。

SBS AE センサシステム



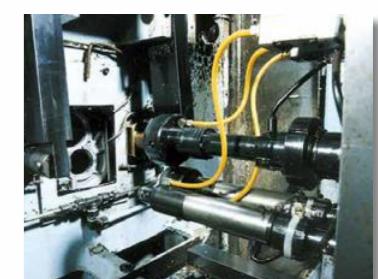
ピン・ジャーナル仕上げ研削



外径マルチ測定+真円度測定



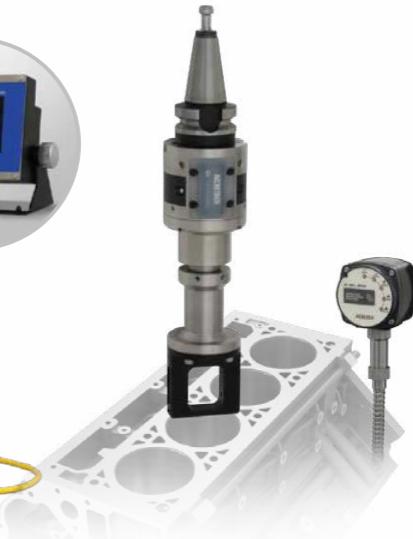
シリンダーライナー ボーリング後加工

シリンダーブロック測定刻印機  
ボア径、クランク穴径、クランク穴同軸度等を測定し、所定のマーキングを行う自動機です。

旋盤後工程用 内径測定システム



内径測定



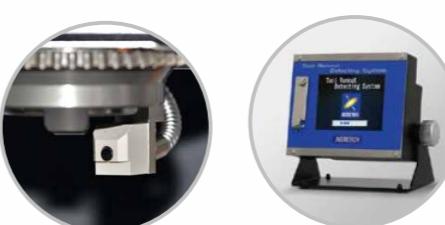
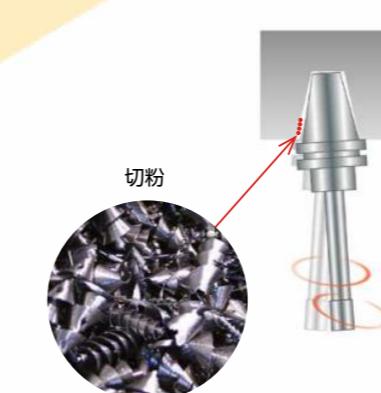
マシニングセンタ用測定システム

完成品



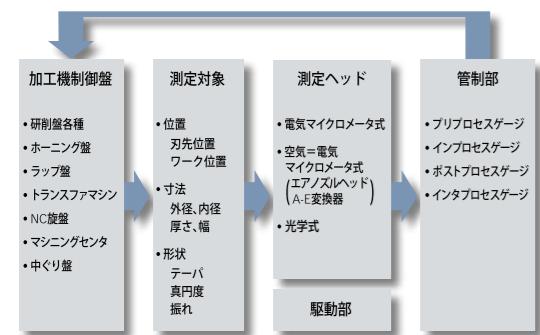
総合自動検査機

完成品



## 自動計測機器 マシンコントロールゲージ

## Machine Control Gages



インラインでの高精度測定・機器制御をリアルタイムに行う強力なラインナップを揃えました。

マシンコントロールゲージ・パルコムは、加工中あるいは加工前後に測定したデータをもとに、工作機械をリアルタイムに制御する装置です。東京精密のマシンコントロールゲージの最大の特長は、他を凌駕するその高精度にあります。従来製品の精度を大幅に上回る 0.1 μm という高精度測定システムを開発し、ますます高精度化する加工技術を強力にバックアップ。幅広い環境に設置可能な完全防水構造なので、さまざまなラインに対応し、インラインでの高速測定・機器制御を実現します。また、各種の自動測定・刻印・選別機もカスタムメイドで供給しており、パルコムとともに、国内ではもとより海外でも広く採用され、高い信頼を得ています。

## 各種測定ヘッド

- 安定性向上(温度特性に優れた測定ヘッド)
- 小型、省スペース



## マシンコントロールゲージ 管制部

## パルコム V9

**CC-Link**

## パルコム V10A + V11

- 真円度測定、SPC 制御などの豊富な機能

**ACCRETECH**

Accretech SBS Products

**SBS**  
DYNAMIC BALANCE SYSTEM

## SBS オートバランサシステム

- 厚倒的な堅牢さ、圧倒的にスピーディー
- 加工品質維持・向上を実現



## SBS AE センサシステム

- 高度な解析性能、優れた操作性
- 加工監視とサイクルタイム短縮に最適

## 自動計測機器 センサおよび解析・表示部

## Sensors, Analyzers and Display Units

コンパクトで高精度。そしてラインで鍛え抜かれた信頼性を発揮します。

東京精密は、様々な測定原理に基づく豊富なセンサを揃え、ライン計測のあらゆるニーズに応えます。長い実績を持ち高く評価されているこれらのセンサ類は、ラインの中の測定に求められる「扱いやすさ」や「視認性」、機器組み込みに必要な「高速応答性」、検査室用途に求められる「高精度」をすべて兼ね備えています。さらにお客様のニーズをいち早くとらえて、各種の非接触センサなどの製品開発を積極的に行ってています。

## 空気マイクロメータ



デルタ 22H

## 高精度デジタル測長器

## PHA シリーズ



## PC 接続型検査装置

## USB 接続

- PC にて測定
- USB パスパワーにて動作
- マルチゲージシステム



## 多彩なラインナップ

- LVDT-USB : コンパクトな測定ヘッド、電気マイクロメータ
- PHA-USB : 高精度、広測定範囲、光学スケールゲージ
- Air micro USB : エアノズルにより検出した微小寸法変化を電気量に変換

## アルミ高速切削加工監視装置

## ATC 振れ検出システム

- 振れを検出して加工不良を防止するシステム



## 接触式 ウェーハ厚さ測定機

## WT-425シリーズ



## ATC 用内径測定ヘッド 無線ボアゲージ

## BG-300

- 無線通信を用いた ATC 対応型のボアゲージ



半導体製造装置 ウェーハプロービングマシン

## Wafer Probing Machines

次代が要請するデバイス進化・測定ニーズに対応。

最先端のインテリジェント機能を搭載したソリューションを提供し、  
測定業界をリードし続けます。

東京精密は、ウェーハ製造・デバイス検査装置のトップメーカーとして、常に積極的な技術開発を推し進めてきました。

この永年に及ぶ高度なノウハウと最新の技術を結集して、さらなる製品を皆さまにお届け致します。



### AltaProv

弊社独自の、新接触方式 ポゴピンを採用。  
本機専用のXYステージにより 12ステージの同時測定を実現した、  
一括接触向けプロービングマシンです。

### 新世代超高性能プロービングマシン

高精度、ハイスループット（インデックス移動、ウェーハハンドリング、ウェーハアライメント）、低振動、静粛を高水準で達成した新世代高性能プロービングマシンです。

新たにウィルス・マルウェア対策ソフトウェアを標準搭載しました。

また、前機種からの機能と操作性を継承、レシピ・マップデータの互換性も維持し、安全・安心・簡単にご使用いただけます。



### AP3000

先進的テクノロジーを駆使し、次世代デバイスの微細化・高集積化に伴う  
プロービング技術の多様化に対応する最上位モデル。



### AP3000e

当社が培ってきたコア技術がさらに進化、様々なお客様のニーズや  
テスト環境に高コストパフォーマンスでお応えする汎用モデル。



### FP3000W

ダイシング用フレームにマウントされた薄いウェーハ、  
ダイシング済みウェーハ、CSP 基板を自動搬送し  
プロービングテストします。



### UF3000EX-iS

シングルプロービングマシンと同機能を有し、最小限のフットプリントを実現しました。  
小品種大量生産向けプロービングマシンです。

## 半導体製造装置 ウェーハプロービングマシン

多様なデバイス要求に応える  
プローバ・バリエーション UF シリーズ。

東京精密の最新の技術を結集して開発されたのが、UF シリーズのプロービングマシンです。高精度、高性能、高機能であることはもちろん、完全自動化、自己診断機能、GUI 採用など、高い操作性と安定性を実現致します。



**UF2000**

- 高精度 200 mm ウェーハ機  
 $\pm 1.5 \mu\text{m}$  精度、高剛性、高いスループットを実現した  
 プロービングマシン。高プロセッサの採用と新しいローダの  
 性能でウェーハ処理に威力を発揮します。



**FP2000**

- 高精度 200 mm ウェーハ、CSP/WCSP 向け  
 フレーム搬送対応プロービングマシン。



**UF200R**

- ハイスループット、ハイコストパフォーマンス  
 プロービングマシン



**UF190R**

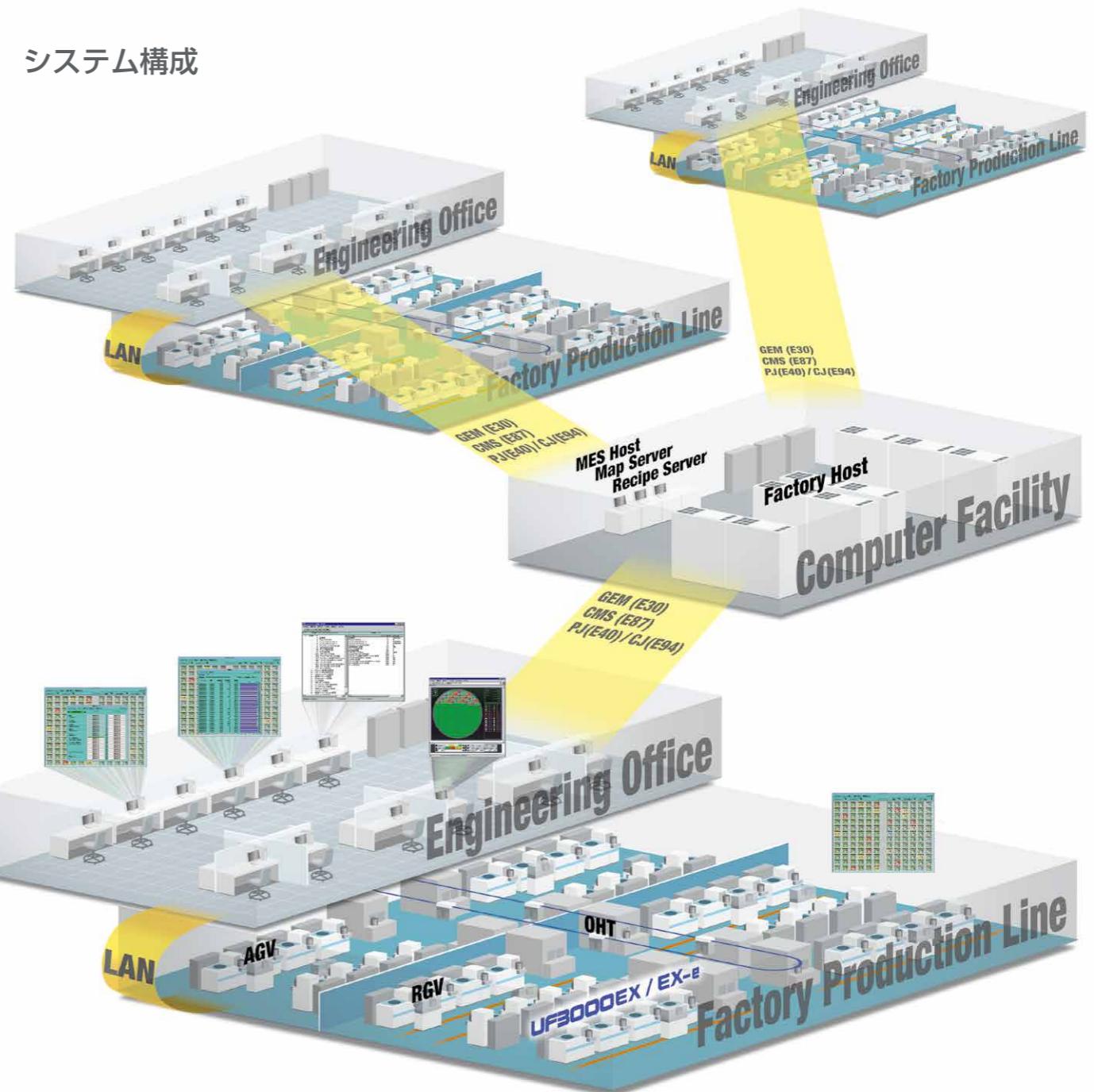
- ディスクリート向け高速プロービングマシン

お客様のテスト工程品質とデータの管理、テスト結果解析、  
 自動化に ACCRETECH ネットワークが力を発揮します。

### System Integration

ACCRETECH のプロービングマシンは、SEMI の GEM (E30)、CMS (E87)、PJ (E40)、CJ (E94) などの規格の他、オリジナルネットワークである Vega-Net、Light-Veganet、及び Vega-Planet を組み合わせることにより、ファクトリーオートメーションをリード致します。UF シリーズでは、次世代リモートターミナル機能を搭載し、e-Maintenance / e-Diagnostic を提供致します。

### システム構成



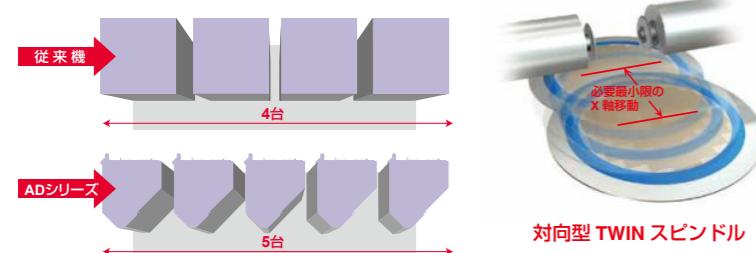
半導体製造装置 フルオートマチックダイシングマシン

## Fully Automatic Dicing Machines

省フットプリント化を追求したデザイン、高メンテナンス性を兼ね備えた装置コンセプトで最適なダイシング環境をご提案します。

東京精密のフルオートマチックダイシングマシンは、高スループットと高加工品質により、優れたCoO (Cost of Ownership) を実現します。フロアスペースを有効活用し、生産効率を最大限に発揮する為に、独自開発した斜めレイアウト機構の採用。高剛性・門型構造と対向型Twinスピンドルの組合せにより、省フットプリントでありながら、2軸スピンドルによる高生産性を実現します。

**ADシリーズは、従来機と比較して小型化に成功しました。**



AD3000T-PLUS

- 対向型 Twinスピンドル搭載の300 mmワーク対応フルオートダイサ
- 高出力スピンドル標準装備
- 豊富なオプション設定  
中間ドレス機能、内蔵UV照射システム、イオナイザー etc オプションユニットの小型化、内部最適設計により主要オプションユニットの内蔵が可能



AD3000T-HC PLUS

- 対向型 Twinスピンドル搭載の300 mmワーク対応フルオートダイサ
- WH/FH自動切替え  
ウェーハ・ハンドリング(WH)仕様とフレーム・ハンドリング(FH)仕様をレシピ設定で簡単に自動切り替え出来ます。  
段取り替えの工数削減や、オペレーションミス防止に貢献します。



AD2000T/S

- 対向型 Twinスピンドル／Singleスピンドル搭載の200 mmワーク対応フルオートダイサ
- 高出力スピンドル標準装備



AD3000TW

- 大型パッケージ基板に対応する対向型TWINスピンドル搭載モデル
- Fan-out WLPをはじめとした、大型化するパッケージ基板のダイシングに対応
- 特殊なダイシングフレーム、角テーブルを選択することで、パッケージ基板の多枚貼りに対応、生産性向上とコストダウンに貢献

半導体製造装置 セミオートマチックダイシングマシン

## Semi-Automatic Dicing Machines

ユーザーフレンドリーな操作で高加工品質を実現します。

東京精密は長年培ってきた切断ノウハウを定量化することによって切断条件を総合的に判断し、お客様が加工するそれぞれのウェーハに最適な加工条件を実現し、常に高品質加工を維持します。GUI (Graphical User Interface) を全てのダイサに標準装備、自動アライメント機能との組み合わせにより、オペレータへの負担が少ない、ユーザーフレンドリーなオペレーションを提供します。

AD30TW

- 大型パッケージ基板専用ダイサ  
基板サイズ最大360mm×360mmまで対応可能。
- 対向型 TWINスピンドルデザイン  
必要最小限のX軸移動、2軸同時加工による生産性の向上。
- 高性能・高出力スピンドル標準搭載



最大360mm×360mmの大型パネルまで対応可能  
(250mm × 75mm 5枚貼りの例)



AD20T/S

- 省スペース設計  
斜めレイアウト機構の採用により、当社従来比40%の省フットプリント化を実現。
- 対向型 Twinスピンドル／Singleスピンドル搭載の200 mmワーク対応セミオートダイサ。
- 高性能・高出力スピンドル標準搭載



SS30



SS20



SS11



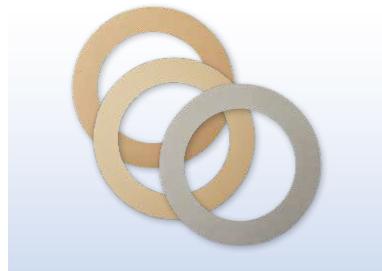
オートマチック  
ウェーハ洗浄機

- 300 mmウェーハに対応した洗浄・乾燥を行うウェーハ洗浄機。
- セミオートマチックダイシングマシン等で切断・溝加工されたワークのスピン洗浄・乾燥に最適です。

## 半導体製造装置 精密切断ブレード

**Precision ACCRETECH Blades**

東京精密の精密切断ブレードは、独創的開発技術とアプリケーション技術の融合により、あらゆる被削材や加工用途に対応できる製品をラインナップし、お客様が求める「高品位、低成本」のニーズにお応えします。



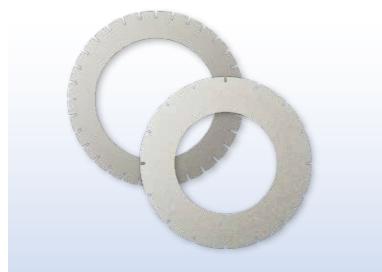
&lt;メタルブレード&gt;

金属ボンドベースのブレードです。優れた材料技術を基に幅広いラインナップを取り揃えております。ガラス用にはGMシリーズ、セラミック用にはYMシリーズを用途に合わせてお選び下さい。



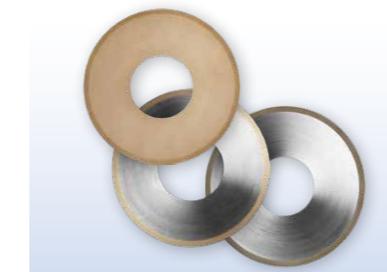
&lt;レジンブレード&gt;

樹脂ボンドベースのブレードです。高い切れ味を維持し、ハイスピード、長寿命化を目指しています。半導体パッケージにはPGシリーズを、ガラス・セラミックスにはGCシリーズを、用途に合わせてお選び下さい。



&lt;ニッケルブレード&gt;

電鋸法を利用したニッケルボンドベースのブレードです。世界に認められたその性能は高い安定性をお約束します。ニッケルブレードの持つ剛性、耐摩耗性を活かしつつ電子材料切断分野での可能性を追求し続けます。



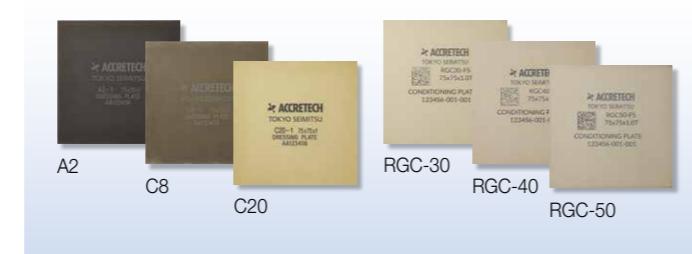
&lt;ダイヤモンドカッター&gt;

金属製台金の外周部に砥粒層を持つカッターです。厚刃、大口径など砥粒を多く使用するサイズでコストダウンを実現します。



&lt;超硬メタルソー&gt;

さまざまな樹脂や金属基板を砥粒ではなく、切れ刃により切削することでバリを発生させない超硬メタルソー。最適なソリューションで、さまざまなニーズにお応えします。



&lt;ドレッシングプレート・コンディショニングプレート&gt;

品質の安定とブレードの切れ味を保つドレッシングプレート。最適な条件下でのドレスにより、ブレードの性能を最大限に引き出します。

## 半導体製造装置 フルオートマチック レーザダイシングマシン

**Fully Automatic Laser Dicing Machines**

Siウェーハ表面に損傷を与える非接触でのダイシングが可能

IRレーザを搭載したΦ300mm対応 レーザダイシングマシン。お客様の様々なニーズに対応できるよう、種々のローダー仕様を完備。

レーザダイシングマシン  
ML3200FHレーザダイシングマシン  
AL3000

このレーザダイシングマシンは、ストリート上のLow-k膜やCu配線、TEGなどをUVレーザ光を用いて、低ダメージで除去します。

**【特徴】**

- Φ300mm対応 フルオートレーザダイシングマシン  
水溶性保護膜湿布から、レーザダイシング、洗浄まで一連の工程を自動対応
- Laser grooving process対応  
Low-kグルービング、ストリート上のTEG除去など
- 独自のレーザエンジン機構により、高品質加工と高スループットを両立

半導体製造装置 高剛性研削盤

## High Rigid Grinders

短時間でダメージのない加工を実現。

東京精密の高剛性研削盤は、難削材料として知られているサファイア基板やSiC基板などの硬脆性材料を研削する装置です。

HRG300は、大口径ワーク(300mm)の枚葉研削加工や支持基板に取り付けた小径ワークのバッチ研削加工が可能です。



**HRG300**

特長

- 高剛性
- 高加工能率
- 低加工コスト
- バッチ処理対応 IPG 搭載
- 常時ドレス機構（オプション）



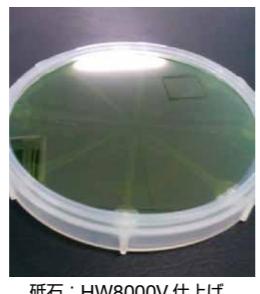
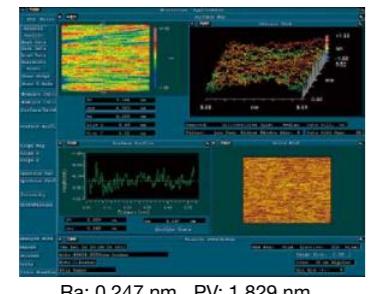
**HRG200X**

特長

- 全自動高剛性 2 軸研削盤
- 短時間でダメージがない加工を実現
- 低加工コスト
- 高精度加工
- 鏡面加工を実現

SiC の加工事例

研削だけで鏡面加工が可能になります。



対象材料

サファイア SiC GaN ALN LT 等の難削材

対象ワーク

サイズ:  $\phi$  2 ~  $\phi$  12 インチ  
最大厚さ: 20mm (支持基盤の厚さを含む)

半導体製造装置 高剛性研削盤

研削盤の限界を追究。

ケミカルレスにて鏡面加工を実現

高精度、高スループット、低成本でウェーハの薄膜化工程に貢献します。



**HRG3000RMII**

特長

- 全自動高剛性 3 軸研削盤
- 短時間でダメージがない加工を実現
- 低加工コスト
- 高精度加工
- 鏡面加工を実現

半導体製造装置 ポリッシュ・グラインダ

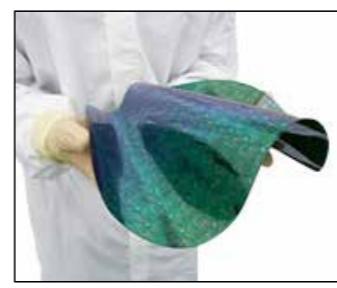
## Polish Grinders

東京精密独自の発想から生まれたポリッシュ・グラインダはシステム・イン・パッケージ(SiP)や三次元実装技術に要求されるウェーハの薄片化とダメージ除去を1台の装置で実現することにより、搬送によるウェーハの割れ欠け問題を解決します。



特長

- 工程の集積: 粗研削・仕上研削・ポリッシング工程ウェーハの両面洗浄を1台の装置で実現
- 安全対策: ウェット工程のため発塵無し
- 安定した搬送: 研削されたウェーハは着脱されることなく薄板化の工程を完了させて次工程へ搬送
- 通信機能: 薄いウェーハの受け渡しを最小回数に抑えるための搬送機構とインライン接続する RM モジュールをも含むデータ管理と通信
- 品質管理: ポストプロセスゲージを用いたデータ管理と通信



対象材料

Si SiC Glass Mold package etc..

対象ワーク

サイズ:  $\phi$  8 ~  $\phi$  12 インチ  
最小仕上げ厚み: 10μm

## 半導体製造装置 CMP装置

**Chemical Mechanical Planarizers**

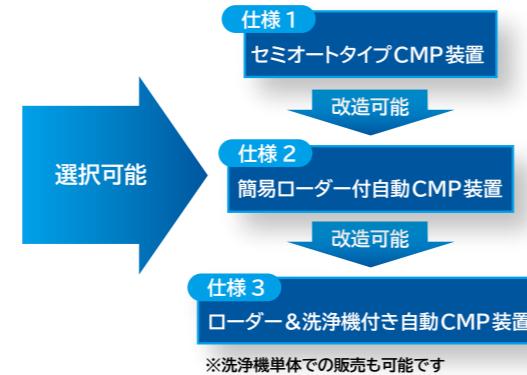
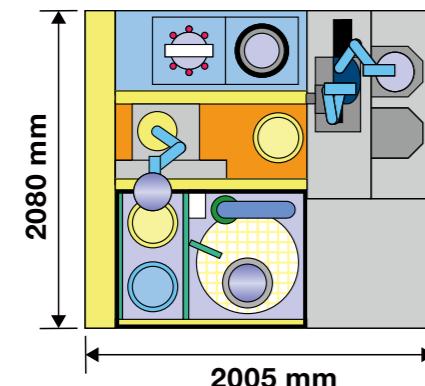
東京精密は、これまで培ってきた精密計測機器及び半導体製造装置の技術を融合し、多様なプロセス要求に応える装置ChaMP シリーズをご提供します。  
(対応ウェーハサイズ:300 mm、200 mm、150 mm、100 mm)

## 小型・高性能 CMP 装置

**ChaMP 211**

## 特長

- 低価格、小 footprint
- 高性能 CMP : 半導体デバイス量産ラインで培った技術
- ご要望に応じて、装置仕様変更が可能  
→ R&D から試作、量産まで拡張可能



## 標準モデル

**ChaMP 232**

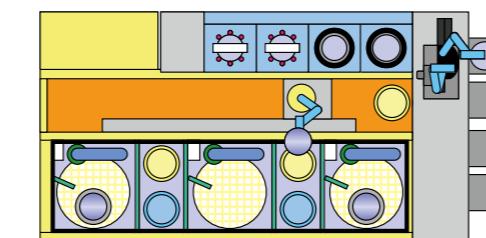
200 mm/150 mm/100 mm ウェーハ対応

**ChaMP 332**

300 mm ウェーハ対応

## 特長

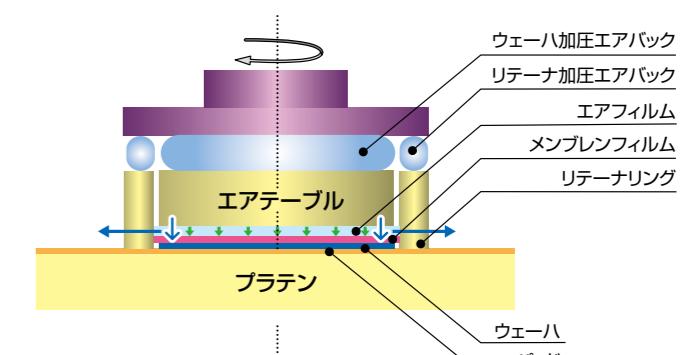
- 3 プラテン 2 ヘッド構成により、あらゆるアプリケーションに対応可能
- 300 mm/200 mm/150 mm/100 mm ウェーハ対応機すべて同一コンセプトの研磨ヘッドと EPD システムを搭載可能



低圧かつ高平坦化・高スループット研磨を実現したエアフロート式ヘッド “Sylphide”

- エアフィルム形成によるウェーハ面内で非常に均一な加圧
- エアフィルムと独立したエアバッグを持つことで低圧での安定性を実現
- 独立したリテナー加圧エアバッグにより良好なエッジプロファイル制御を実現
- リテナー・メンブレンのワンタッチ交換によるダウンタイムの低減（下記参照）
- ゾーンコントロール機能の追加可能（オプション）

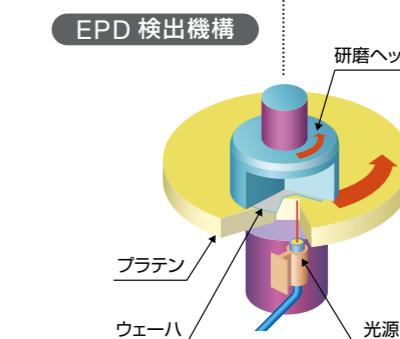
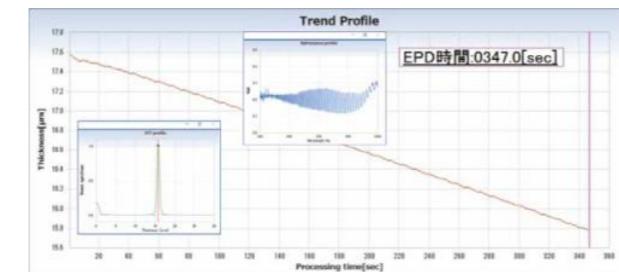
Sylphide



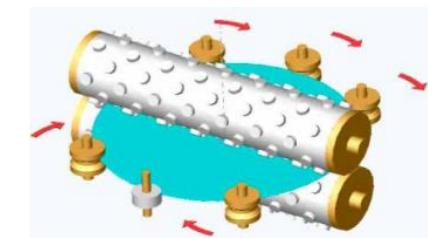
弊社の CMP 装置のヘッド性能の高さはプロセス性能の向上だけでなく、生産性の向上やコストの低減につながります。例えば、平坦性の高い硬質パッドが適用できることにより、研磨時間の短縮とそれに伴う消耗材コストの低減、ウェーハ有効面積の拡大が実現できます。

**Optical End-Point Detection System**

- 白色光源を用い、広い波長領域の反射データと独自のアルゴリズムで正確に残膜変化を検出
- 幅広いアプリケーションの提供
- 膜厚の推移が分かる直観的な GUI

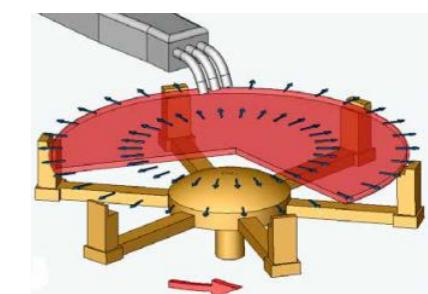


スクラブ洗浄

**洗浄機**

- 300 mm/200 mm/150 mm/100 mm ウェーハ 四角などの特殊な基盤にも柔軟に対応
- 最先端プロセスに対応した洗浄を実現
- 表・裏面の同時洗浄が可能

スピン乾燥



半導体製造装置 ウェーハマニュファクチャリングシステム

# Wafer Manufacturing Systems

シリコンウェーハ製造機器のトップメーカーとして蓄積してきた技術による  
ウェーハ製造プロセスのシステム化を実現しました。

半導体デバイスの微細化が進むのに伴い、シリコンウェーハに対する更に精密な加工技術が求められています。東京精密では、ウェーハ製造工程におけるインゴットスライス後のウェーハ剥離洗浄、面取り工程等、品質と生産性の向上を図るウェーハ製造ラインでの装置を提供し、その自動化及びプロセス管理に最適なシステムの提案、ならびにサポートを行っています。主力製品の大口径300 mm ウェーハ対応の面取り機及び剥離洗浄機はお客様の高い評価を受け世界販売シェアトップクラスの地位を確保しています。



**W-GM-4200E**

- 50 mm ( $\phi$  2") ~ 200 mm ( $\phi$  8") ウェーハ対応機
- 新開発研削部によりスピンドル回転精度が向上し、加工粗さを改善
- 加工前のウェーハ厚さ・ノッチの深さを非接触測定

**W-GM-4200S**

- 様々な形状（四角形、異形）に対応



**ウェーハ剥離洗浄機 C-RW-200/300**

- スライシングマシン/ワイヤソーで切断したウェーハをスライスベースから剥離・洗浄し、カセットに収納するまでを全自動で行います。



**W-GM-6200**

- ウェーハサイズ  $\phi$  450 mm
- コンパクトな設計でスペース効率アップ
- 新X軸・Y軸・Z軸の同期補完制御による高精度な研削
- タッチパネリによる簡単操作



**W-GM-5200E**

- ウェーハサイズ  $\phi$  300 mm
- 高精度・高品質な300 mmウェーハ加工を実現
- 新開発のビルトイン・インスペクション・システム（オプション）により研削後のウェーハの品質管理を、装置内においてリアルタイムでモニタ可

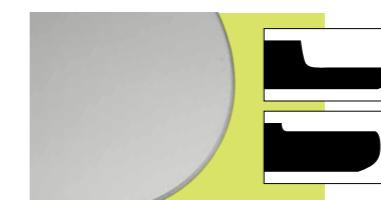
## ウェーハ加工

弊社面取り機は、Si、SiC、GaN、Sapphire、化合物・酸化物等、様々な素材、用途でご使用して頂いております。  
これまで蓄積してきた加工技術をご提供いたします。

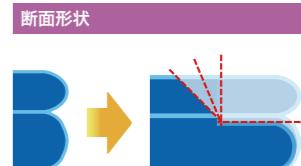
### 加工実績 仕上げ面粗さ ( $R_a = 20 \text{ nm}$ ) ※当社基準による算出



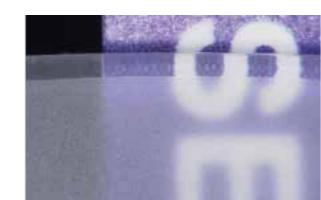
Si ウェーハ 2 ~ 18 inch 各サイズ



特殊形状のエッジ加工（テラス加工）  
ナイフエッジ対策 非対称形状



タイミング加工  
張り合わせウェーハの面取り



Sapphire ウェーハ 鏡面取り



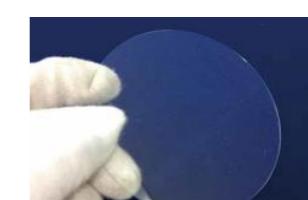
SIC、Sapphire、脆性材料のノッチ  
研削



SiC、GaN 等、化合物ウェーハ面取り



インゴットの芯取り  
最大厚さ 30 mm



ガラスウェーハの面取り



四角基盤の面取り

## 東京精密のCSRの考え方

東京精密グループは、企業理念「世界中の優れた技術・知恵・情報を融合して世界No.1の商品を創り出し、皆さまと共に大きく成長していく」に基づいて事業活動を行っております。これらを通じてお客様、株主の皆さま、サプライヤさま、従業員、地域社会、国際社会など全てのステークホルダーとの間でWIN-WINの関係を創りあげ、持続可能な社会の実現に向け積極的に役割を果たすとともに、企業価値の向上に努めます。

## MOTTO

### WIN-WIN の仕事で世界 No.1 の商品を創ろう



## 会社概要

会社商号  
株式会社 東京精密  
TOKYO SEIMITSU CO., LTD.

### 事業目的

1. 各種測定機器、試験機ならびに装置の製造修理および販売
2. 精密機械、工作機械ならびに各種専用機の製造修理および販売
3. 各種精密部品、工具、治具、ゲージの製造販売
4. 電気機器、自動制御機器の製造修理および販売
5. 材料物性分析用小型加速器の製造販売
6. 自動販売機の製造販売
7. 不動産の売買、賃貸、仲介、管理および倉庫業
8. 動産、不動産のリース業
9. 損害保険代理業および生命保険の募集業務
10. 古物の売買、リース、交換又は委託による同業務
11. 上記各号に関連する一切の業務

### 設立年月日

昭和24年(1949年)3月28日

### 資本金

11,573百万円  
(2025.3.31現在)

### 株式

東京証券取引所プライム市場に上場

### 従業員数

1,292名(単体) 2,767名(連結)  
(2025.3.31現在)

取締役・監査役	関係会社
代表取締役会長 吉田 均	(株) 東精エンジニアリング
代表取締役社長CEO 木村 龍一	(株) トーセーシステムズ
取締役 伯耆田 貴浩	(株) アクレーテク・クリエイト
取締役 ロミ プラダン	(株) 東精ボックス
社外取締役 高増 潔	(株) アクレーテク・ファイナンス
社外取締役 森 重哉	(株) アクレーテク・パワトロシステム
取締役(常勤監査等委員) 秋本 伸治	Accretech America Inc.
社外取締役(監査等委員) 相良 由里子	Accretech (Europe) GmbH
社外取締役(監査等委員) 川崎 素子	Accretech Korea Co., Ltd.
社外取締役(監査等委員) 高山 清子	東精精密設備(上海)有限公司 (2025.6.23現在)
	Accretech Taiwan Co., Ltd. Accretech (Malaysia) Sdn. Bhd. Accretech (Thailand) Co., Ltd. Accretech Adamas (Thailand) Co., Ltd. 東精計量儀(平湖)有限公司 TOSEI (Thailand) Co., Ltd. Accretech SBS Inc. Accretech (Singapore) Pte. Ltd. Accretech Vietnam Co., Ltd. PT Accretech Indonesia Accretech-Tosei do Brasil Ltda. PT TOSEI Indonesia. TOSEI Philippines Corp. TOSEI Engineering Pvt. Ltd. TOSEI Mexico, S.A. de C.V. Accretech SBS UK Ltd. Accretech-Tosei Hungary Kft. 東精精密設備(平湖)有限公司

## 沿革

1949	・東京精密工具株設立	2002	・2部門において1OBEST賞を受賞 Test & Material Handling Equipment 部門では 7年連続受賞 Assembly Equipment部門では初受賞
1951	・メカニカルゲージを応用した各種測定機の製作販売開始		・東精精密設備(上海)有限公司設立
1952	・高圧流量式空気マイクロメータのわが国初の工業化に成功		・浜松ホトニクスと半導体製造装置分野で業務提携 新型レーザダイシング装置 「MAHOH DICING MACHINE」を共同開発
1957	・差動変圧器式電気マイクロメータのわが国初の工業化に成功		
	・第一精機株設立	2005	・カールツァイス社(独)との提携を5年更新
1958	・ゲルマニウムペレット厚さ自動選別機の開発	2007	・ACCRETECH Korea, Co., Ltd. 設立
1962	・株式会社東京精密に社名変更 ・東京証券取引所市場第二部に株式上場 ・表面粗さ測定機の開発		・MAHOH DICING MACHINEが第27回優秀省エネルギー機器表彰で日本機械工業連合会会長賞を受賞
1963	・内周刀式ウェーハスライシングマシンのわが国初の開発に成功		・計量法トレーサビリティ制度に基づく長さ測定用 レーザの校正および三次元座標測定機の定置校正 認定事業者として土浦工場が認定取得
1964	・ウェーハプローピングマシンの開発	2008	・2部門において1OBEST賞受賞 Test & Material Handling Equipment 部門では 13年連続受賞 Assembly Equipment部門では7年連続受賞
1967	・真円度測定機の開発		・非接触センサで三軸光器と技術提携
1969	・(株)東精エンジニアリング設立 ・三次元座標測定機のわが国初の開発		・Accretech America Inc.設立
1970	・ウェーハダイシングマシンの開発	2009	・本社を八王子に移転
1985	・ソフトウェア開発専門会社(株)トーセーシステムズを (株)シーアイシーと共同で設立	2010	・半導体社 八王子工場第五工場完成
1986	・東京証券取引所市場第一部に株式上場	2011	・三菱マテリアルよりブレード事業譲渡 ブレード事業開始
1987	・技術研究所設立	2012	・デバイスプロセスの多様化に対応したACCRETECH Application Centerを開設
1989	・ドイツに現地法人Tokyo Seimitsu Europe GmbH設立 ・米国に現地法人Tokyo Seimitsu America, Inc.設立	2015	・Tokyo seimitsu (Thailand) Co., Ltd.を Accretech (Thailand) Co., Ltd.に社名変更
1992	・韓国に現地法人(株)ACCRETECHサービスセンター開設 ・第一精機(株)を(株)マイクロテクノロジに社名変更	2016	・半導体社 八王子工場第六工場完成
1994	・八王子・土浦両工場一括でISO 9001の認証取得 ・計量法トレーサビリティ制度に基づく長さ測定用 レーザの校正認定事業者として八王子工場が認定取得 ・北京駐在事務所開設 ・マレーシアに現地法人 Tokyo Seimitsu(Malaysia) Sdn. Bhd. 設立	2017	・プラスマダイシング工法の普及に向け レーザグリーピング装置で パナソニック フاكتري-ソリューションズと協業
1995	・計量法トレーサビリティ制度に基づく端度器 (ブロックゲージ)の校正認定事業者として 土浦工場が認定取得 ・米国に現地法人ACCRETECH America, Inc. およびACCRETECH Manufacturing Company 設立 ・カールツァイス社(独)と精密測定機器分野で全面提携	2019	・株式会社アクリテク・パワトロシステムの設立 (旧:株式会社富士通テレコムネットワークス福島の 株式取得により社名変更)
1996	・半導体製造装置サプライヤー顧客満足度調査 (VLSIリサーチ社調べ)で1OBEST賞を受賞 ・台湾新竹市にテクニカルセンター開設	2020	・ACCRETECH SBS Inc. ACCRETECH SBS UK Ltd. の設立 (子会社である株式会社東精エンジニアリングによる、 Schmitt Industries, Inc. のバランサ事業及び英國 子会社の授受により設立)
1997	・Tokyo Seimitsu (Singapore) Pte. Ltd. 設立		・土浦工場M1棟竣工
1998	・八王子・土浦工場一括でISO 14001の認証取得		・ベトナム現地法人半導体事業部門 オフィスの開設
1999	・(株)アクリテク・パワトロシステム(旧(株)富士通 テレコムネットワークス福島)の完全子会社化完了		・(株)アクリテク・パワトロシステム(旧(株)富士通 テレコムネットワークス福島)の完全子会社化完了
2001	・コーポレートブランド「ACCRETECH(アクリテク)」を導入 ・(株)東精ボックス設立	2021	・ACCRETECH TAIWAN CO., LTD. の新社屋完成
		2022	・台湾新アリケーションセンタを設立
		2023	・東京証券取引所 市場区分見直しによりプライム市場へ移行
			・半導体社 飯能工場竣工
			・連結子会社である株式会社アクリテク・パワトロシステムから、充放電試験装置の開発・製造・販売事業の譲受
			・名古屋工場竣工

## カンパニー制および執行役員体制

### 〈半導体社〉

カンパニー長 伯耆田 貴浩  
執行役員常務 久保 祐一  
執行役員常務 金澤 雅喜  
執行役員常務 井出 良一  
執行役員 ロミ プラダン  
執行役員 ティーケン ホイ  
執行役員 酒井 広幸  
執行役員 東 正幸  
執行役員 赤田 幸治  
執行役員 坂田 亮

### 〈計測社〉

カンパニー長 石川 一政  
執行役員常務 藤田 太一  
執行役員 増田 岳史  
執行役員 小野 瞳  
執行役員 菊田 徹也  
執行役員 外川 陽一  
執行役員 増田 光

### 〈業務会社〉

カンパニー長 加藤 朝史  
執行役員常務 小泉 公人  
執行役員 猪瀬 朋子

## ネットワーク

### 東京精密 本社・工場



(株)東京精密 本社  
〒192-8515  
東京都八王子市石川町2968-2  
TEL(042) 642-1701  
FAX(042) 642-1798



八王子工場  
〒192-0032  
東京都八王子市石川町2968-2  
TEL(042) 642-0381  
FAX(042) 642-0386



土浦工場  
〒300-0006  
茨城県土浦市東中貫町4  
TEL(029) 831-1234  
FAX(029) 831-4453



飯能工場  
〒357-0069  
埼玉県飯能市西台2-7-1  
TEL(042) 649-1371  
FAX(042) 649-1197



古殿工場  
〒963-8304  
福島県石川郡古殿町大字松川大作50  
TEL(0247) 53-4111  
FAX(0247) 53-4918

### 東精エンジニアリング 本社・工場

※東精エンジニアリングは東京精密のグループ会社であり、半導体製造装置・自動計測機器を製造しております



(株)東精エンジニアリング本社  
〒300-0006  
茨城県土浦市東中貫町4-6  
(東京精密 土浦工場隣)  
TEL(029) 830-1888  
FAX(029) 832-4053



神立工場  
〒300-0015  
茨城県土浦市北神立町2-14  
TEL(029) 830-1882  
FAX(029) 832-4053



名古屋工場  
〒470-0151  
愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字東諸輪5  
(東諸輪交差点北東)  
TEL(0561) 57-0700  
FAX(0561) 57-0800



新潟工場  
〒959-0132  
新潟県燕市分水あけぼの1-1-74  
TEL(0256) 97-1771  
FAX(0256) 97-1773



みよし工場  
〒470-0213  
愛知県みよし市打越町新池浦96  
TEL(0561) 32-3601  
FAX(0561) 34-2744

### 国内営業・サービスネットワーク

#### ■半導体製造機器

##### ■取扱営業所

東京営業所  
〒192-0032 東京都八王子市石川町2968-2  
(東京精密 八王子工場内)  
TEL(042) 642-0358 FAX(042) 642-0367

北陸出張所  
〒939-8015 富山県富山市中川原31-1  
(ウインドスクエア101)  
TEL(029) 830-1882 FAX(029) 832-4053

大阪営業所  
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-18-27  
TEL(06) 6821-0361 FAX(06) 6821-0210

九州営業所  
〒861-8043 熊本市 東区戸島西1-29-20  
TEL(096) 282-8493 FAX(096) 282-8495

##### ■サービス

北上出張所  
〒024-0084 岩手県北上市さくら通り3-13-1  
(ジョイフルタット101)  
TEL(022) 224-0177 FAX(022) 224-7083

仙台出張所  
〒984-0816 宮城県仙台市若林区河原町2-6-22  
(ロイヤルヒルズ河原町)  
TEL(022) 224-0121 FAX(022) 224-7083

山形出張所  
〒990-0056 山形県山形市錦町3-20  
(須藤ビル)  
TEL(023) 631-5125 FAX(023) 625-4129

鶴岡出張所  
〒997-0015 山形県鶴岡市末広町29-20  
TEL(0235) 29-8020 FAX(0235) 29-8022

東京CE課／土浦出張所  
〒300-0006 茨城県土浦市東中貫町4  
(東京精密 土浦工場内)  
TEL(029) 834-8550 FAX(029) 831-6808

東京CE課／神立出張所  
〒300-0015 茨城県土浦市北神立町2-14  
TEL(029) 817-3077 FAX(029) 832-5742

#### ■株式会社 東精エンジニアリング (ウェーハマニュファクチャーリングシステム)

##### 土浦半導体工場

〒300-0015 茨城県土浦市北神立町2-14  
TEL(029) 830-1882 FAX(029) 832-4053

##### 土浦半導体工場／パーツセンター

〒300-0015 茨城県土浦市北神立町2-14  
TEL(029) 830-1882 FAX(029) 832-4053

#### 《精密測定機器・充放電試験装置》

##### ■取扱営業所

東北営業所  
〒984-0816 宮城県仙台市若林区河原町2-6-22  
(ロイヤルヒルズ河原町)  
TEL(022) 224-0121 FAX(022) 224-7083

北関東営業所  
〒300-0006 茨城県土浦市東中貫町4  
(東京精密 土浦工場内)  
TEL(029) 831-6801 FAX(029) 831-6808

長崎出張所  
〒854-0053 長崎県諫早市小川町82-3  
(堀川ビルA102)  
TEL(096) 387-5188 FAX(096) 386-1592

九州CE課  
〒861-8043 熊本市 東区戸島西1-29-20  
TEL(096) 282-8494 FAX(096) 282-8495

九州CE課／大分出張所  
〒870-0915 大分県大分市花高松1-A棟3号室  
TEL(097) 503-1035 FAX(097) 503-1036

国分出張所  
〒899-5117 鹿児島県霧島市隼人町見次515  
(秀保ビル101号)  
TEL(0995) 43-2510 FAX(0995) 43-2586

新潟営業所  
〒959-0132 新潟県燕市分水あけぼの1-1-74  
TEL(026) 97-4665 FAX(026) 75-0754

八王子パーツセンター  
〒192-0032 東京都八王子市石川町2968-2  
(東京精密 八王子工場内)  
TEL(042) 642-0381 FAX(042) 642-0397

#### ■サービス ■株式会社 東精エンジニアリング

※サービスは当社グループ会社である東精エンジニアリングが請け負っております

北陸営業所  
〒939-8015 富山県富山市中川原31-1  
(ウインドスクエア101)  
TEL(076) 422-6755 FAX(076) 422-6757

長野営業所  
〒390-0852 長野県松本市大字島立442-2  
(あらいビル2F C号室)  
TEL(0263) 44-7770 FAX(0263) 44-7771

浜松営業所  
〒435-0042 静岡県浜松市中央区篠ヶ瀬町971  
TEL(053) 546-0181 FAX(053) 546-0153

名古屋営業所  
〒300-0006 茨城県土浦市東中貫町4-6  
(東京精密 土浦工場隣)  
TEL(029) 830-1888 FAX(029) 832-4053

東北出張所  
〒990-0056 山形県山形市錦町3-20  
(須藤ビル1F)  
TEL(023) 625-3957 FAX(023) 625-4129

古殿営業所  
〒963-8304 福島県石川郡古殿町松川大作50  
TEL(0247) 53-4111 FAX(0247) 53-4918

太田営業所  
〒373-0818 群馬県太田市小舞木町454-2  
(NKマンショウ1F)  
TEL(0276) 48-5221 FAX(0276) 48-5223

さいたま営業所  
〒331-0814 埼玉県さいたま市北区東大成町1-497 (MJ赤柴ビル8F)  
TEL(048) 669-0055 FAX(048) 667-8578

広島営業所  
〒733-0005 広島県広島市西区三滝町12-35  
(ハイム三滝1F)  
TEL(082) 534-0011 FAX(082) 534-0013

九州営業所  
〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院1-13-8  
(九電不動産ビル5F)  
TEL(092) 737-1821 FAX(092) 737-1822

東京営業所  
〒190-0012 東京都立川市曙町1-22-17  
(アーバンセンター立川2F)  
TEL(042) 595-8123 FAX(042) 595-8145

厚木出張所  
〒243-0014 神奈川県厚木市旭町4-11-26  
(ジェントビル3F)  
TEL(046) 229-2448 FAX(046) 282-6185

北陸出張所  
〒939-8015 富山県富山市中川原31-1  
(ウインドスクエア101)  
TEL(076) 422-6401 FAX(076) 422-6402

##### 長野営業所

